

2017-2022年中国晶圆代工产业现状深度调研及市场发展前景预测报告

报告大纲

一、报告简介

智研咨询发布的《2017-2022年中国晶圆代工产业现状深度调研及市场发展前景预测报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.chyxx.com/research/201612/474541.html>

报告价格：电子版: 9800元 纸介版：9800元 电子和纸介版: 10000元

订购电话: 010-60343812、010-60343813、400-600-8596、400-700-9383

电子邮箱: sales@chyxx.com

联系人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

报告目录：

第一章晶圆制造简介21
第一节晶圆制造流程21
第二节晶圆制造成本分析27
第二章半导体市场32
第一节2017-2022年半导体产业预测32
第二节2016年半导体市场下游预测34
第三节全球晶圆代工产业现状35
第四节全球半导体制造产业38
一、全球半导体产业概况38
二、全球晶圆代工行业概况39
第五节中国半导体产业与市场44
一、中国半导体市场44
二、中国半导体产业47
三、中国ic设计产业56
四、中国半导体产业发展趋势59
第三章晶圆代工产业简介61
第一节晶圆制造工艺简介61
第二节全球晶圆产业及主要厂商简介62
第三节中国半导体产业政策环境70
第四节中国晶圆制造业现状及预测73
第四章晶圆厂研究76(ZYWZY)
一、中芯国际76
（一）企业偿债能力分析77
（二）企业运营能力分析79
（三）企业盈利能力分析82
二、上海华虹nec电子有限公司83
（一）企业偿债能力分析85
（二）企业运营能力分析87
（三）企业盈利能力分析90
三、上海宏力半导体制造有限公司92
（一）企业偿债能力分析93
（二）企业运营能力分析95

- (三) 企业盈利能力分析98
- 四、华润微电子99
 - (一) 企业偿债能力分析100
 - (二) 企业运营能力分析102
 - (三) 企业盈利能力分析105
- 五、上海先进半导体106
 - (一) 企业偿债能力分析107
 - (二) 企业运营能力分析109
 - (三) 企业盈利能力分析112
- 六、和舰科技(苏州)有限公司113
 - (一) 企业偿债能力分析114
 - (二) 企业运营能力分析116
 - (三) 企业盈利能力分析119
- 七、bcd(新进半导体)制造有限公司120
 - (一) 企业偿债能力分析121
 - (二) 企业运营能力分析123
 - (三) 企业盈利能力分析126
- 八、方正微电子有限公司127
 - (一) 企业偿债能力分析128
 - (二) 企业运营能力分析130
 - (三) 企业盈利能力分析133
- 十、南通绿山集成电路有限公司134
 - (一) 企业偿债能力分析135
 - (二) 企业运营能力分析137
 - (三) 企业盈利能力分析140
- 十一、纳科(常州)微电子有限公司141
 - (一) 企业偿债能力分析144
 - (二) 企业运营能力分析146
 - (三) 企业盈利能力分析149
- 十二、珠海南科集成电子有限公司150
 - (一) 企业偿债能力分析151
 - (二) 企业运营能力分析153
 - (三) 企业盈利能力分析156
- 十三、康福超能半导体(北京)有限公司157
 - (一) 企业偿债能力分析157

- (二) 企业运营能力分析159
- (三) 企业盈利能力分析162
- 十四、科希-硅技半导体技术第一有限公司163
 - (一) 企业偿债能力分析163
 - (二) 企业运营能力分析165
 - (三) 企业盈利能力分析168
- 十五、光电子(大连)有限公司170
 - (一) 企业偿债能力分析170
 - (二) 企业运营能力分析172
 - (三) 企业盈利能力分析175
- 十六、西安西岳电子技术有限公司176
 - (一) 企业偿债能力分析177
 - (二) 企业运营能力分析179
 - (三) 企业盈利能力分析182
- 十七、吉林华微电子股份有限公司183
 - (一) 企业偿债能力分析185
 - (二) 企业运营能力分析187
 - (三) 企业盈利能力分析190
- 十八、丹东安顺微电子有限公司191
 - (一) 企业偿债能力分析191
 - (二) 企业运营能力分析193
 - (三) 企业盈利能力分析196
- 十九、敦南科技198
 - (一) 企业偿债能力分析199
 - (二) 企业运营能力分析200
 - (三) 企业盈利能力分析203
- 二十、福建福顺微电子205
 - (一) 企业偿债能力分析206
 - (二) 企业运营能力分析208
 - (三) 企业盈利能力分析211
- 二十一、杭州立昂212
 - (一) 企业偿债能力分析213
 - (二) 企业运营能力分析215
 - (三) 企业盈利能力分析218
- 二十二、杭州士兰集成电路219

- (一) 企业偿债能力分析220
- (二) 企业运营能力分析222
- (三) 企业盈利能力分析224
- 二十三、hynix-st半导体公司226
 - (一) 企业偿债能力分析226
 - (二) 企业运营能力分析228
 - (三) 企业盈利能力分析231
- 二十四、台积电232
- 二十五、联电237
- 二十六、特许239
- 二十七、东部亚南dongbuanam240
- 二十八、世界先进241
- 二十九、jazz半导体241
- 三十、magnachip242
- 三十一、silterra243
- 三十二、x-fab245
- 三十三、stsilicon246
- 三十四、towersemiconductor246
- 三十五、episiltechnologies247
- 三十六、ibm247

图表目录：

- 图表1晶圆制造工艺流程21
- 图表2晶圆尺寸变化影响加工成本趋势分析27
- 图表32016年度全球营收前13的晶圆代工企业35
- 图表42017-2022年大陆ic内需市场规模变化与预测36
- 图表5主要代工企业产能分布及收益情况41
- 图表6集成电路技术节点及其对应研发和建厂费用43
- 图表7全球半导体市场规模超过3000亿美元47
- 图表8半导体产品种类繁多48
- 图表9全球半导体分产品市场占比48
- 图表10中国大陆半导体市场规模近4000亿元49
- 图表11全球半导体产业区域结构发生巨大变化50
- 图表12北美半导体设备制造商bb值51
- 图表13半导体产业链51
- 图表14近期或者未来有望在a股上市的半导体厂商52

- 图表15半导体产业链上封测环节技术壁垒相对较低53
- 图表16封测环节在半导体产业链中的相对进入壁垒54
- 图表17集成电路封测行业一直占据行业主导地位55
- 图表18国内十大半导体封装测试企业56
- 图表192016年全球晶圆代工排名63
- 图表202012-2016年全球前三大半导体厂商营收与成长趋势64
- 图表21全球半导体厂商资本支出占营收比例之比较65
- 图表22前三大半导体厂商资本支出与占营收比例趋势66
- 图表23全球半导体厂商资本支出集中程度分析67
- 图表24半导体设备厂商于18寸晶圆生产设备投资考虑情境分析68
- 图表25全球半导体设备产业版图的改变69
- 图表26国内政策对集成电路产业大力支持71
- 图表27国内半导体进口金额超2000亿美元71
- 图表28国内集成电路未来三阶段发展目标73
- 图表29近3年中芯国际有限公司资产负债率变化情况77
- 图表30近3年中芯国际有限公司产权比率变化情况78
- 图表31近3年中芯国际有限公司固定资产周转次数情况79
- 图表32近3年中芯国际有限公司流动资产周转次数变化情况80
- 图表33近3年中芯国际有限公司总资产周转次数变化情况81
- 图表34近3年中芯国际有限公司销售毛利率变化情况82
- 图表35近3年上海华虹nec电子有限公司资产负债率变化情况86

详细请访问：<https://www.chyxx.com/research/201612/474541.html>